



# 8440 HS

## Information Produit

40µm translucent HAF mounting tape

## Description produit

### Caractéristiques

- Reliable chip module bonding
- Suitable for PVC, ABS and PC cards
- Good workability on all common implanting lines
- Good ageing resistance
- Invisible on assembled card

### Application

tesa HAF® 8440 is especially designed for the embedding of chip-modules into smart cards.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |              |                      |          |
|--------------------------|--------------|----------------------|----------|
| • Support                | aucun        | • Type de protecteur | glassine |
| • Type de masse adhésive | co-polyamide | • Epaisseur totale   | 40 µm    |

### Propriétés / Valeurs de performance

- Force de collage 12 N/mm<sup>2</sup>

### Infos complémentaires

Technical Recommendations:

The following values are recommendation for machine parameters to start with. Please note that optimum parameters strongly depend on the type of machine, particular materials for card bodies and chip-modules as well as customer requirements.

#### 1. Pre-lamination:

During pre-lamination, the adhesive tape is laminated onto the module belt. This step can be performed inline or offline. The pre-lamination step does not effect the shelf life time of the adhesive tape.

Machine setting:

- Temperature 130 - 140 °C
- Pressure 2 - 3 bar
- Time 2.5 m/min

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=08440>



# 8440 HS

## Information Produit

### Infos complémentaires

#### 2. Module Embedding:

During module embedding, the pre-laminated modules are die cut from the module belt, positioned into the card cavity and permanently bonded to the card body by heat and pressure. For this step, the exact handling depends on the type of the implanting line used. Single step and multiple step can be used. Today, multiple step is common:

Single step process - Machine setting :

- Temperature<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 75 N/module
- Time 1.5 s

Multiple step process (2 or more heating stamps) - Machine setting:

- Temperature<sup>1</sup> 180 – 220 °C
- Pressure 65 - 75 N/module
- Time 2 x 0,7 s. /3 x 0.5 s

<sup>1</sup> Temperature as measured inside the heating stamp. Different temperature settings are recommended for different card material:

- \*PVC 180 - 190 °C
- \*ABS 180 - 190 °C
- \*PC 200 - 220°C

For applicants other than chip module implanting, different machine parameters should be used.

Bonding strength values were obtained under standard laboratory conditions. Value is guaranteed clearance limit checked with each production batch (Material: Etched aluminium test specimen / Bonding conditions: Temp. = 120 °C; p = 10 bar; t = 8 min)

Storage conditions according to tesa HAF® shelf life concept.

## Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=08440>